

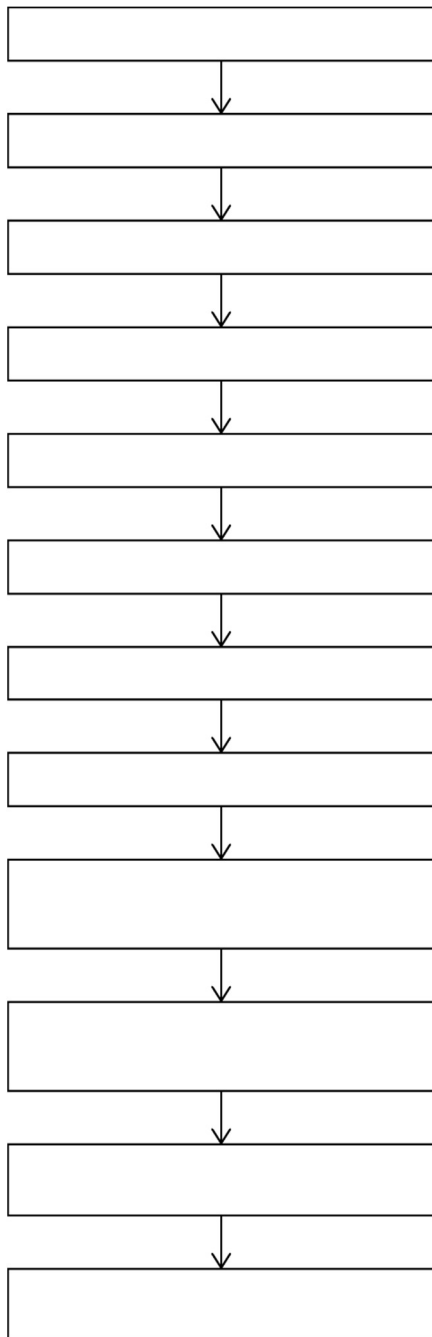
Aufgabe 7.1

Wie werden Leiterplatten konstruktiv eingeteilt?

- Einebenenleiterplatte
- Einlagenleiterplatte
- Zweiebenleiterplatte
- Mehrlagenleiterplatte
- Mehrebenenleiterplatte
- starre Leiterplatte
- biegsame Leiterplatte
- durchkontaktierte Leiterplatte

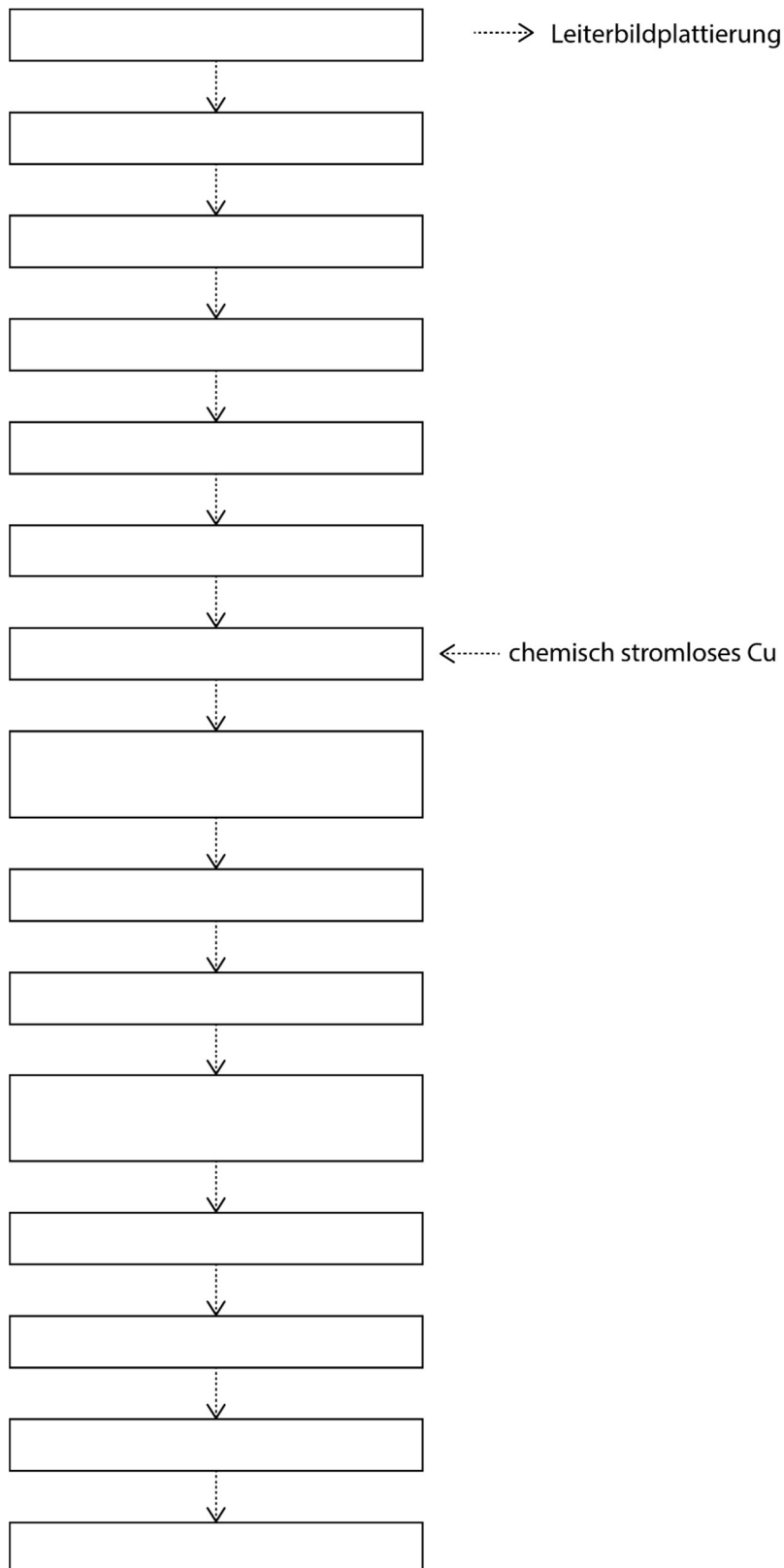
Aufgabe 7.2

Stellen Sie den Prozessablauf bei der Herstellung von Einebenenleiterplatten in Subtraktivtechnik dar! Ausgangspunkt ist kupferkaschiertes Basismaterial.



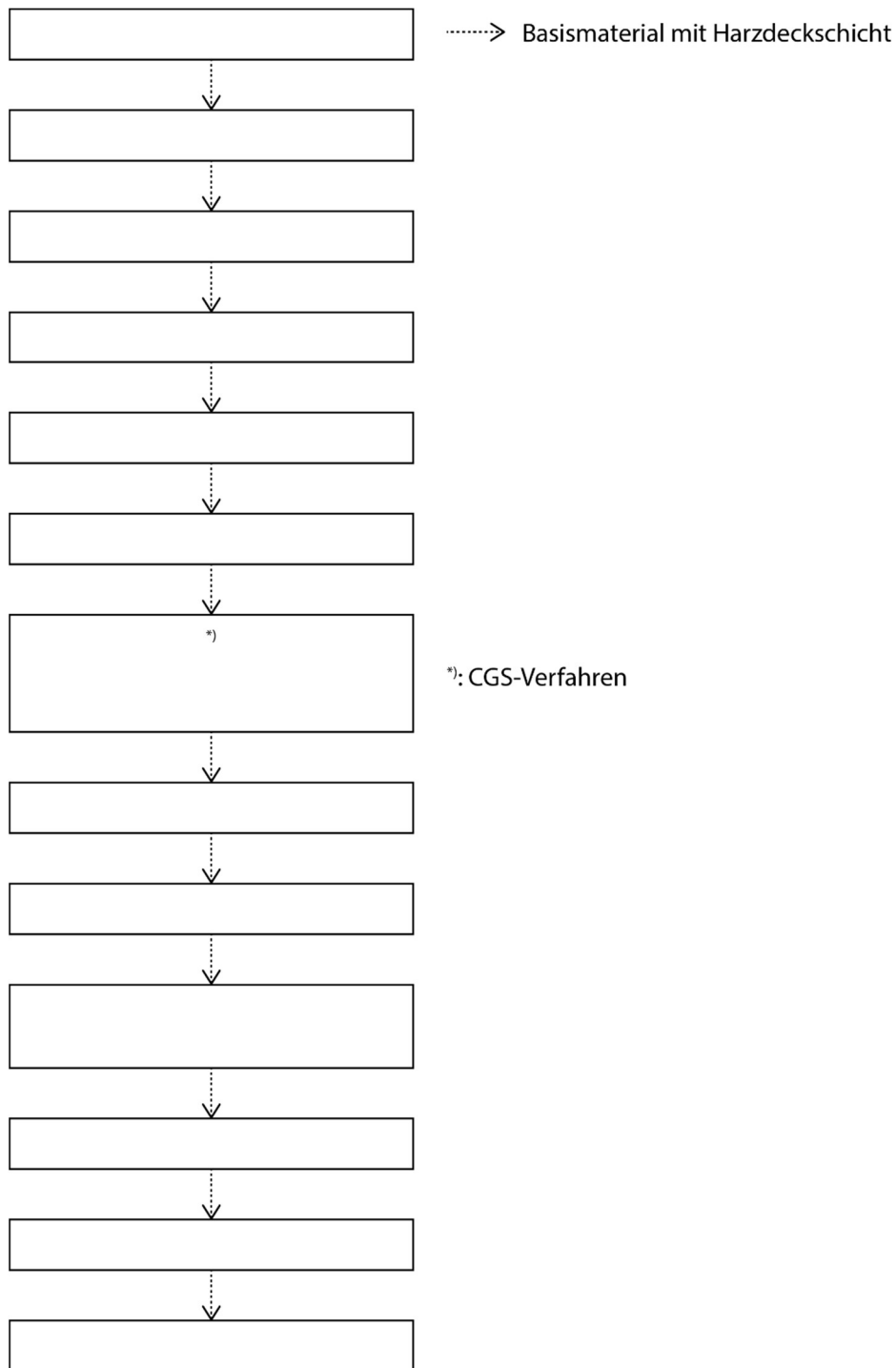
Aufgabe 7.3

Stellen Sie den Prozessablauf bei der Herstellung von durchkontaktierten Leiterplatten in Subtraktivtechnik dar (Leiterbildplattierung)! Ausgangspunkt ist kupferkaschiertes Basismaterial.



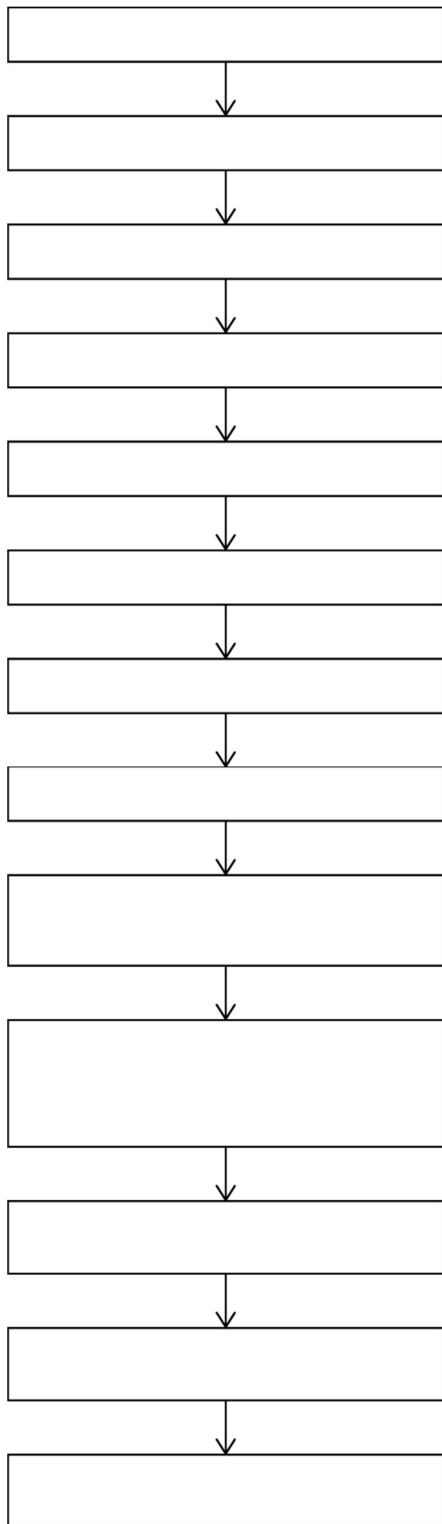
Aufgabe 7.4

Stellen Sie den Prozessablauf bei der Herstellung von durchkontaktierten Leiterplatten in Semiadditivtechnik dar! Wählen Sie die Variante mit dem CGS-Verfahren! Ausgangspunkt ist **unkaschiertes Basismaterial mit Harzdeckschicht**.



Aufgabe 7.5

Stellen Sie den Prozessablauf bei der Herstellung von durchkontaktierten Leiterplatten in Volladditivtechnik dar! Ausgangspunkt ist unkaschiertes Basismaterial.



Aufgabe 7.6

Welche Oberflächenfinishes für Leitbahnen werden auf Leiterplatten verwendet?

- Galvanisch Sn
- HAL (Heißluft Lotschicht)
- CAL (Kaltluft Lotschicht)
- ENIG (NiAu)
- ESIP (AgPd)
- OSP
- PSG
- Lotstoplack

Aufgabe 7.7

Welche Substratwerkstoffe werden für die Dickschichttechnik verwendet?

- Al_3Si_4 -Keramik
- Al_2O_3 -Keramik
- BaTiO_3 -Keramik
- BeO-Keramik
- GaAs-Keramik
- AlN-Keramik
- Glaskeramik
- Boratglas

Aufgabe 7.8

Aus welchen Bestandteilen bestehen Dickschichtpasten?

- Passivierungsphase
- Wirkphase
- Aktivierungsphase
- Lösungsmittel
- Verdünner
- Druckbildner
- Oxidationsmittel
- Gläser

Aufgabe 7.9

Welche Arten von Drucksieben werden in der Dickschichttechnik genutzt?

- indirekte Emulsionssiebe
- direkte Emulsionssiebe
- indirekte Metallmasken
- direkte Metallmasken
- Metallschablonen
- indirekte Photosiebe
- direkte Photosiebe